



SCIENTECH

辛耘企業(3583)

2014 第一季法人說明會

2014年4月25日

營運概況

主要產品

未來展望

科目	2011	2012	2013	1Q13	1Q14
營業收入	2,761,318	2,252,295	3,067,640	613,076	547,630
營業毛利	844,247	793,275	982,937	185,232	162,886
毛利率	30.6%	35.2%	32.0%	30.2%	29.7%
營業費用	658,733	581,512	629,202	151,079	159,781
營業淨利(損)	185,514	211,763	353,735	34,153	3,105
營業利益率	6.7%	9.4%	11.5%	5.6%	0.6%
營業外收入及支出	(21,752)	(925)	(25,935)	7,896	10,101
稅前損益	163,762	210,838	327,800	42,049	13,206
稅前淨利率	5.9%	9.4%	10.7%	6.9%	2.4%
稅後純益(損)	79,020	176,216	249,417	33,854	5,475
EPS(元)	1.21	2.38	3.13	0.45	0.07

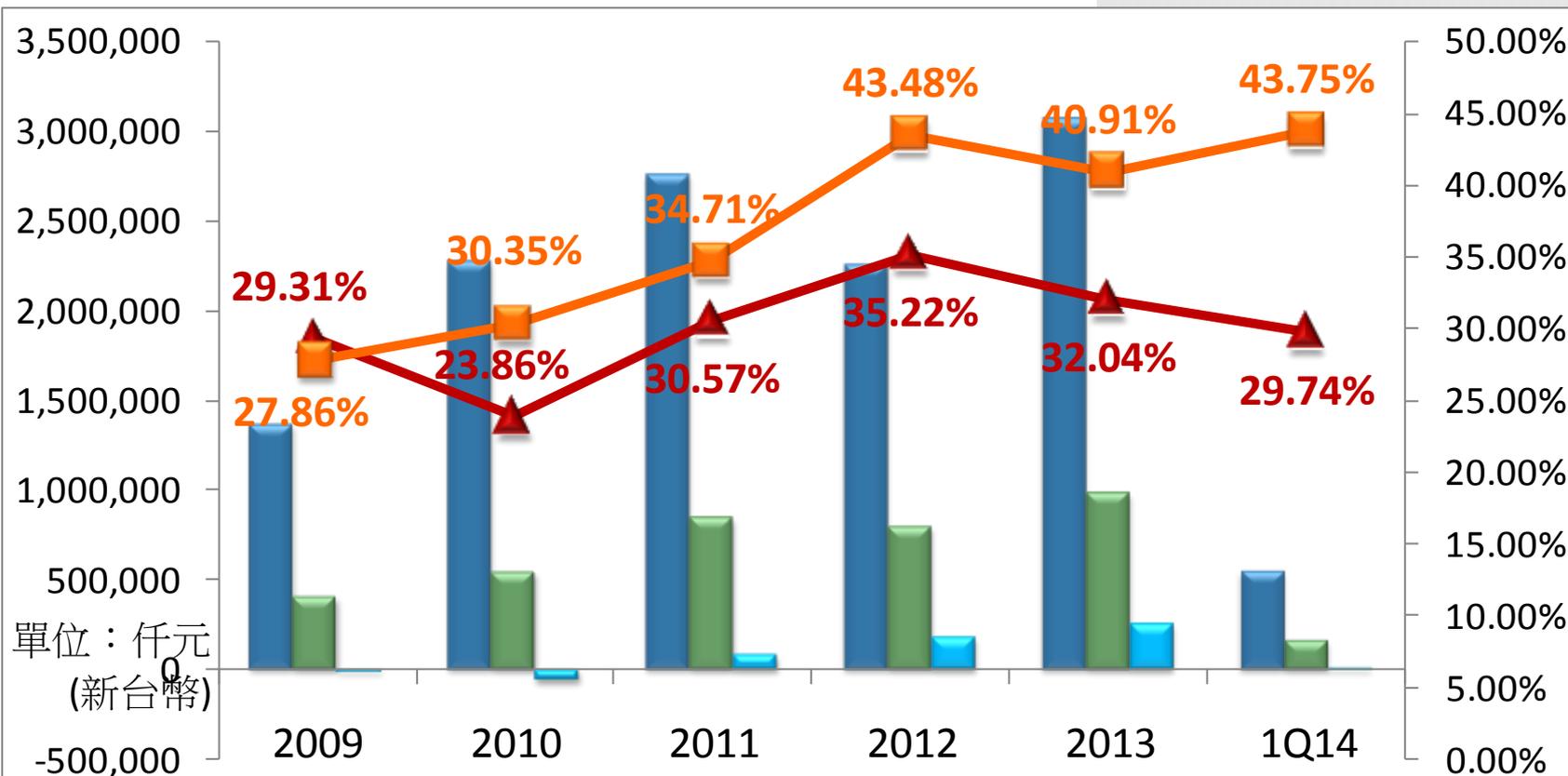
資產負債表項目 (新台幣仟元)	1Q14		4Q13		1Q13	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	453,061	14.3%	396,948	12.2%	377,640	12.1%
應收票據及帳款	388,390	12.3%	556,301	17.1%	312,734	10.0%
存貨	380,110	12.0%	381,777	11.8%	497,024	15.9%
不動產、廠房及設備	1,700,896	53.8%	1,677,423	51.7%	1,592,179	50.9%
資產總計	3,163,963	100.0%	3,246,212	100.0%	3,129,015	100.0%
流動負債	606,547	19.2%	686,765	21.2%	600,295	19.2%
長期銀行借款	567,706	17.9%	576,022	17.7%	648,043	20.7%
負債總計	1,218,737	38.5%	1,308,250	40.3%	1,286,820	41.1%
股東權益總計	1,945,226	61.5%	1,937,962	59.7%	1,842,195	58.9%

(新台幣仟元)	1Q14	4Q13	1Q13
期初現金	396,948	356,106	255,691
營業活動之現金流入	163,967	86,727	101,696
資本支出	(105,424)	(45,860)	(52,726)
長短期借款	6,580	(8,307)	(183,363)
現金增資	0	0	249,576
投資及其他	(9,010)	8,282	6,766
期末現金	453,061	396,948	377,640
自由現金流量(*)	58,543	40,867	48,970

*自由現金流量=營業活動之現金流入-資本支出

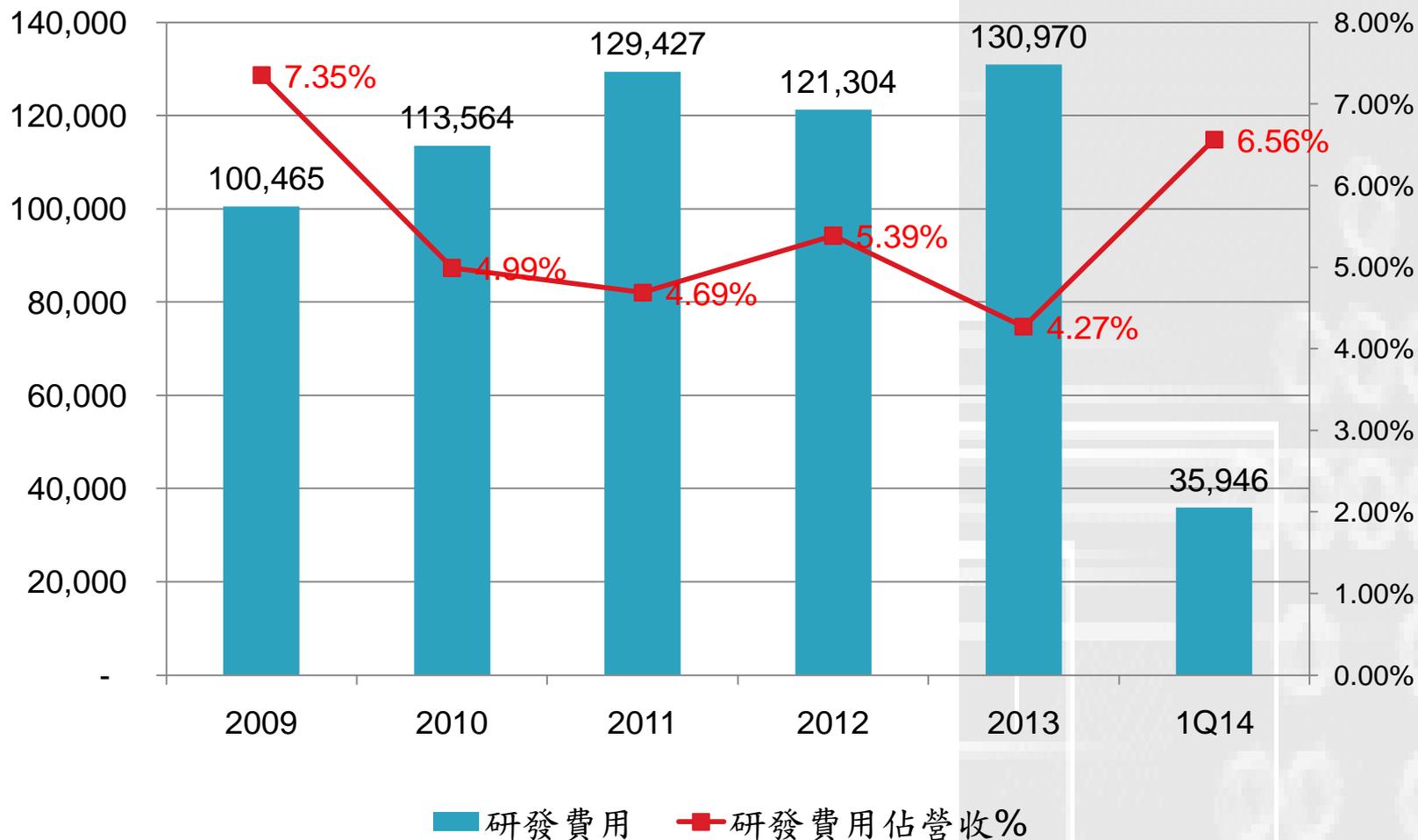
營運概況

營收佔比與毛利率



營業收入	1,366,513	2,275,507	2,761,318	2,252,295	3,067,640	547,630
毛利率	29%	24%	31%	35%	32%	30%
稅後純益(損)	(3,163)	(58,584)	79,020	176,216	249,417	5,475
EPS	0.80	0.09	1.21	2.38	3.13	0.07

■ 營業收入
 ■ 營業毛利
 ■ 稅後純溢(損)
 ▲ 營業毛利率
 ■ 製造事業營收%



● 濕製程設備

■ 單晶圓/批次濕式製程設備

- ◆ **12"/8"** 先進封裝製程：
Bumping / WLP / InFO/ CoWoS/ SiP / TSV / 2.5D IC / 3D IC
- ◆ **6"/8"** 半導體前段成熟特殊製程
(FP sensor、RF、CMOS、Touch Controller、電源管理IC、MEMS、IoT Sensor)
- ◆ **III-V族 for** 無線通訊高頻 IC
(PA 與射頻IC)
- ◆ **HBLED** 全自動前段製程 for 背光與照明



Advanced clean technology
20nm/16nm Particle
Low trace metal (< 5E9)

Complete particle inspection
(SP1-DLS & SP2)

Cleaning

Etching

**Full Process
Optimization**

Polishing

Grinding

12" Wafer Reclaim

月產能: 120K

銅製程與非銅製程產線分離

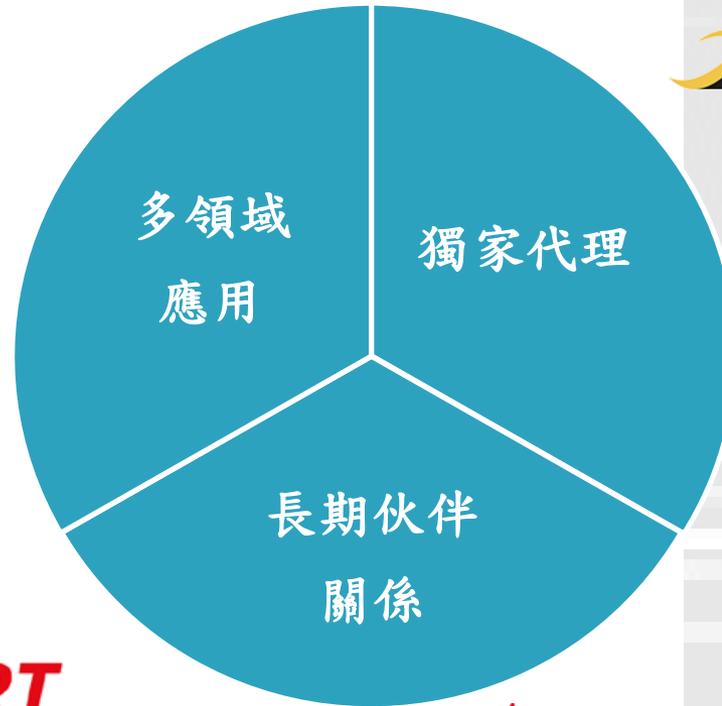
Complete polishing process

Single side polish
Double side polish
Final Haze polish

Super flatness
(GBIR < 0.5 μ m)

主要產品

代理設備



Canon

Revera



ECO-SNOW SYSTEMS

PONGSAN MICROTEC

FerroTec

xradia
insight in 3D

AE ADVANCED ENERGY

Hirata

Plasma-Therm

USHIO

LCP
PLASMA TECHNOLOGIES

KLA Tencor
Already there

VLSI Standards Incorporated

RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL



NAKAN

FRT

Ayumi アユミ工業株式会社
AYUMI INDUSTRY CO., LTD.

タカノ株式会社

ExOne
DIGITAL PART MATERIALIZATION

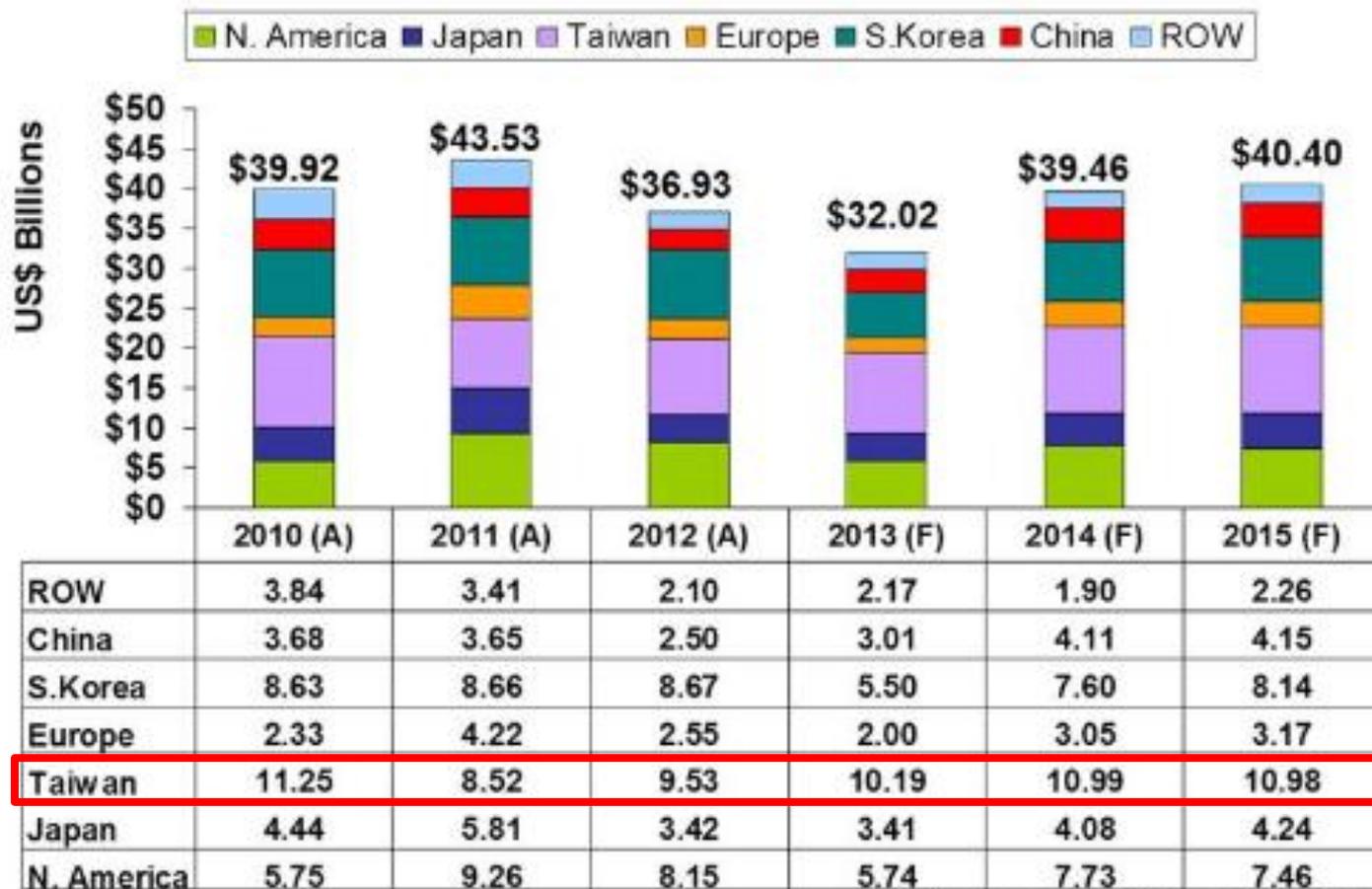
Kensington LABORATORIES

Verity INSTRUMENTS, INC.



NST [주] 엔에스티
NST INC.

2014年半導體設備市場規模與未來預測



Totals may not add due to rounding

自製設備

1. 製程世代能力提升
2. 以核心技術出發，持續掌握外部機會

單晶圓濕製程設備

雷射技術應用(導光板)

全譜質譜儀

晶圓技術

1. 製程世代能力提升
2. 投入非矽材料技術

20/16 nm 矽晶圓再生技術

非矽材料晶圓技術

SiC
(碳化矽):
高功率元件、
RF、電動
汽車電子元
件、高亮度
LED

Ge
(鍺):
高聚型
太陽
能

Glass
(玻璃):
3D IC晶
圓載板

- 12吋單晶圓/批次式濕製程設備

- 先進封裝製程

- ◆ 金屬蝕刻(UBM etch)
- ◆ 晶圓清洗(Wafer clean)
- ◆ 光阻去除(PR Strip)
- ◆ 助焊劑清洗(Flux clean)
- ◆ 金屬化鍍機 (Electro-less plating)



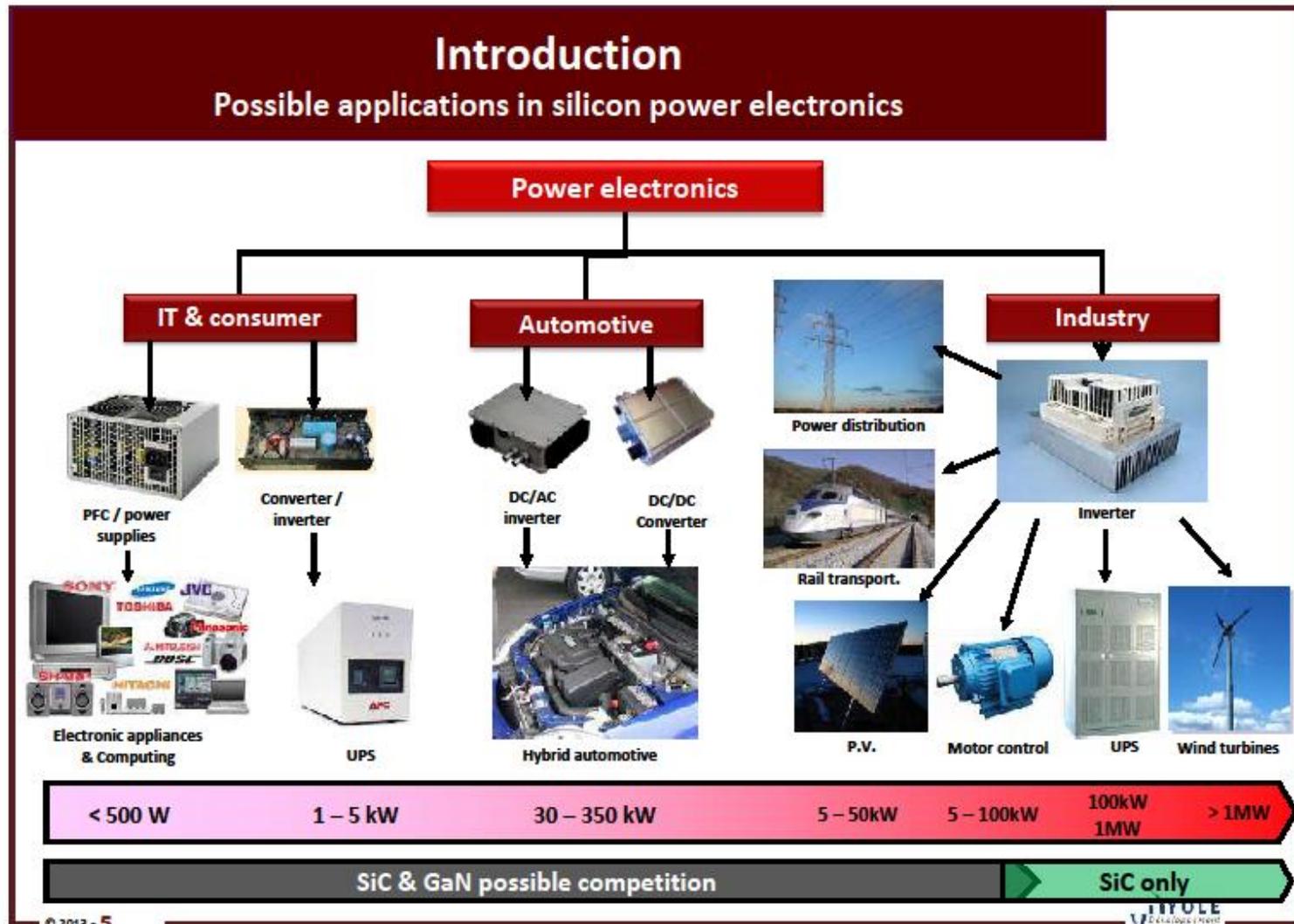
目前質譜儀的應用範疇

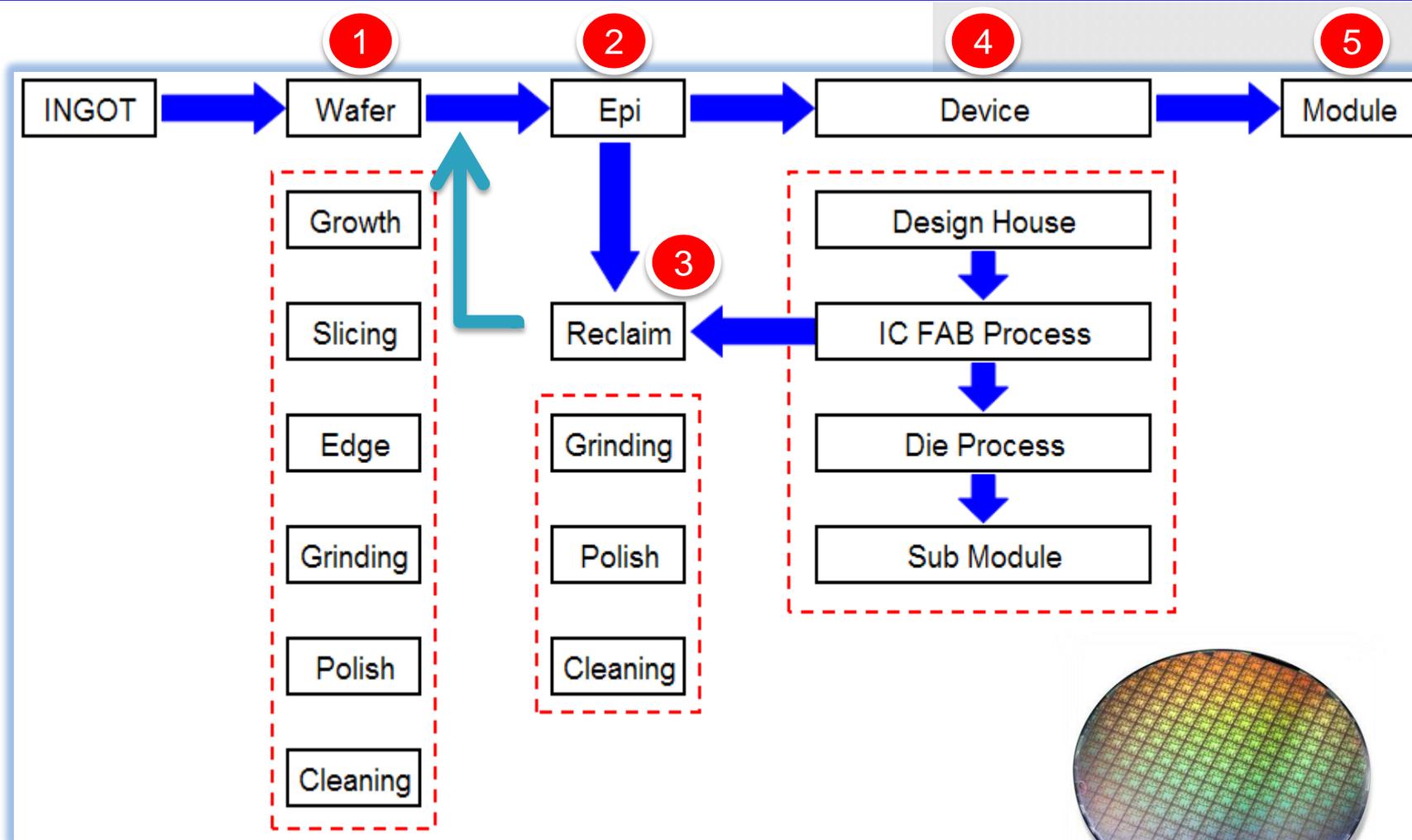
機場或港口的通關檢驗及法醫學方面	食品、毒品、爆裂物或酒精等物品分析
醫藥學方面	藥物代謝、雜質分析、天然產物分析等
臨床醫學方面	新生兒檢查、糖化血色素、血紅蛋白變異等
食品科學方面	香料、添加物、包裝物、蛋白質、致癌物等
研究機構	研究蛋白質、醣類、代謝物的測量、生物分子影像測量、蛋白質體學、修飾蛋白質體學和代謝體學的研究、疾病生物標的物的尋找等
環境化學方面	農藥與農殘分析、有機污染物、土壤/食品/水中粒子分析等
合成與有機化學方面	有機金屬化合物、有機合成物、製造過程的控管及產品的品質管制、表面活性劑、染料等
材料的運用領域	材料不純物的分析，例如在半導體材料，或生醫材料分析…等。

● 質譜儀設備

- 利用專利的掃頻模式，可以偵測目前市面上質譜儀無法偵測的範圍。
- 兼具兩個目前使用最多的離子源：雷射 & 高電壓，可同時分析固態及液態樣品。
- 新開發的應用，包含：
 - ◆ 巨大生物分子
 - ◆ 奈米材料
 - ◆ 環境粒子
 - ◆ 特大分子







簡報結束
謝謝！

Q&A